This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 59122988 A

(43) Date of publication of application: 16 . 07 . 84

(51) Int CI

G01T 1/24 H01L 31/00

(21) Application number: 57230153

(22) Date of filing: 29 , 12 . 82

(71) Applicant.

SHIMADZU CORP

(72) Inventor:

OKA SHOTARO SAWADA RYOICHI

(54) RADIATION MEASURING ELEMENT

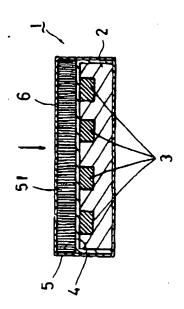
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a small light wt. radiation measuring element having high resolving capacity, by forming a scintillation film having a large number of vertically extended fine needle like structures on an array type semiconductive light detecting element in a closely adhered state through an electromagnetic wave previous film.

CONSTITUTION: A scintillation film 5 comprising CsI(TI) with a thickness of about 160µm is vapor deposited on an array type semiconductive light detecting element obtained by forming n type semiconductive regions 3 on the surface of a p type semiconductive substrate 2 in a heated state through a SiO₂ vapor deposition film 4 with a thickness of about 0.1 µm and, after cooling, cracks are generated in the vertical direction by the difference of coefficient of thermal expansion with the SiO₂ film 4. The whole is coated with an Al vapor deposition protective film 6. Radioactive rays such as X-rays from the direction shown by the arrow are incident to the scintillator film 5 through the protective film 6 to generate fluorescence which is, in turn, subjected to multiple reflection in the needle like sections 51 to reach a light detecting element.

Therefore, a small light wt. radiation measuring element having high resolving capacity is obtained.

COPYRIGHT: (C)1984.JPO&Japio



(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

¹³ 公開特許公報 (A)

昭59-122988

Int. Cl.³G 01 T 1/24H 01 L 31/00

識別記号

庁内整理番号 8105-2G 7021-5F

砂公開 昭和59年(1984)7月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈放射線計測素子

②特 願 昭57-230153

②出 願 昭57(1982)12月29日

⑫発 明 者 岡正太郎

京都市中京区西ノ京桑原町1番 地株式会社島津製作所三条工場 内 切発 明 者 沢田良一

京都市中京区西ノ京桑原町1番 地株式会社島津製作所三条工場

内

切出 願 人 株式会社島津製作所

京都市中京区河原町通二条下ル

一ノ船入町378番地

19代 理 人 弁理士 野河信太郎

明 細 長

1. 発明の名称 放射線計刷素子

2. 特許請求の額囲

- (1) p型(又はn型)半導体基体の表面に複数のn型(又はp型)半導体倒域を分陋形成してなるアレー型半導体光検知素子の上に、電磁波透透性膜を介して、略垂直状にのびる多数の微部針状区順構造を有するシンチレータ膜を密射形成してなることを特徴とする放射線計例素子。
- (2) シンチレータ際の外面に、被刺定放射線を透過しうる保護膜が被觀形成されてなる特許請求の範囲第1項記載の計測案子。
- (3) シンチレータ膜の外面に、シンチレーション による可視光を反射しうる保護膜が被覆形成さ れてなる特許請求の範囲第1項又は第2項記載 の計例素子。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、放射線計測業子に関する。さらに 詳しくは、放射線エネルギーを効率良くかつ高空 間分解能で検知でき、さらに集積化小形化、軽量 化及びハイブリッド化された放射線計測案子に関 する。

近年、CT等の放射線を用いた医療機器や各種放射線側定機器の技術の進歩に伴ない、放射線の強度分布の測定が重要な課題となっている。かような放射線の強度分布の測定器としては多数の区別構成された電離箱を組み合せて各区圏ごとの放射線強度を測定するものが知られているが、これらは援助に弱くさらにその構造が複雑でかつ重く、取扱い上や製造上不利であった。

従つて、より小型化、軽量化された分布側定し うる放射線計測案子が望まれていた。

ての点に関し、この免明の発明者らは半導体光 検出案子に注目した。半導体光検出案子は従来可 視光の検出案子として知られているが、放射線に 対しても若干の感度を有する。そしてその感応邸 分は、半導体光検出素子作製の際に容易にアレー 状に分匯形成できるため、強度分布の測定器とし ては適切なものと考えられる。 しかしながら、 か ようなアレー型の半部体光検出素子を用いた場合 に得られる放射線研定感度はやはり不充分なもの であった。

にのびる多数の微部針状区面構造を有するシンチレータ膜を密着形成してなることを特徴とする放射線計測素子が提供される。

この発明の最も特徴とする点は、アレー型半導体光検出素子と特定の構造を有するシンチレータ膜とを組合せたことにある。上記特定の構造、すなわち略垂直状にのびる多数の数細針状区面構造を有するシンチレータ膜は、X線像強管等の高品質テレビジョン受像管における発光スクリーンとして用いられることは知られている(特公昭55-19029 号公報参照)が、この発明のごとき半導体素子に直接組合せたことはそれ自身新規なものといえる。

以下、必付図面に従いこの発明の放射線計測素 子について辞説する。

第1 図は、この発明の具体例である放射線計型 素子(1)を示す模式的構成説明図である。図におい て、この発明の放射線計型素子(1)は、p型半導体 基体(2)の表面にリン、ヒ素等のドーピングにより 4 つのn型半導体領域(3)を分圏形成してなるアレ であつた。また、この点を改善するためシンチレータ層に多数の区画版(例えば、重金属板等)を入れてクロストーキング現象を防ぐことも考えられるが、形成する区画板自体の幅の薄さにも限度があり、デッドスペースが多く分所能が若干上昇しても全体としての検知効率は不充分であるし、第一、製作上困難を極め、実用に供し得ないものである。

この発明はかような従来の問題点を解消すべく なされたものである。この発明の発明者らは、ア レー型半導体光検出累于に、数細針状区画構造を 有するシンチレータ薄層を形成できる事実を見出 し、さらにこのようなシンチレータ薄膜を用いた ものは区画板等を用いることなく分解能が顕著に 改善され、さらに放射線計測素子の小型化、軽量 化が可能となる事実を見出しこの発明に到達した。

かくしてこの発明によれば、p型(又はn型) 半導体基体の表面に複数のn型(又はp型)半導体領域を分圏形成してなるアレー型半導体光検知 素子の上に、電磁波透過性膜を介して、略垂直状

一型半導体光検出素子、たとえばフォトダイオードの上に、放射線及び可視光を良好に透過する厚み的 0.1 μ m の 8 i O 2 蒸箱膜(4)を介して、厚み約 160 μ m の Cs I (Tℓ) から なる シンチレータ膜(5) を密想形成してなり、 さらにシンチレータ膜(5) の外面を保護すべく、 かつ内部発生療性(6)によりで、 人全体が、 アルミニウム蒸粉保護膜(6)によりでは、アルミニウム蒸粉に対しても関係(5)は、アルー型半導体光検出素子に対しても発展ではでのびる多数の扱細針状区 圏 50 が集積された Cs I (Tℓ) 結晶から増成されてなる。 なおアレー型半導体光検出素子の各 n 型半導体循域は それで割り指標の別チャンネルと機能すべく構成されており指示計器に接続されている。

上記解成の放射線計測索子(1)において、矢印の 方向に進むX株等の放射線は、保護膜(6)を透過し て内部に入射する。との際、放射線の一部はシン チレータ膜(5)を通過してアレー型フォトダイオー ドに入射し、他の一部はシンチレータ膜(5)内でシ ンチレーションによって可視光に変換されアレー

特開昭59-722988(3)

型半導体光検出素子に入射するため、アレー型半導体光検出素子においては放射線及び変換可視光の両方について検知することとなる。従って、シンチレータ膜を有していないものに比して検知効率は改善されている。

さらにシンチレータ [5]は、 略垂直状にのびる 多数の 微細針状区 阿切からなるため、 シンチレーションによって生ずる可視光は、 第 2 図に示すで とくその区 阿内で反射されつつ入射 方向に対応する 半邳体光校出素子の 感応部分 (例えば、 n 型半 導体領域)に効率良く 導びかれ、 クロストーキング 現象を生ずることもない。 従って、 フォトダイオードの 感応部分間の干渉もほとんど生じること なく分解能の 優れた放射線強度の分布が 河定されることとなる。

この発明におけるアレー型半導体光検出業子としては pn 接合型のものを用いたがPIN接合型でも、金属・半導体接触を利用したいわゆる表面障壁型のものでもよい。半導体もシリコンに限らず、ゲルマニウム、各種の化合物半導体等の他の材料

き、これを真空下で200℃ K 保持しつつ厚み 20~ 500 /m 程度のシンチレータ膜を蒸着によつて 形成させ、その後、自然冷却することにより、幅 5~ 20 /m 程度の多数の 微細針状 区 面構造を亀 裂によつて生じせしめることにより得られる。

この発明の上記シンチレータ腰の外面は通常、 湿気等の影響を防ぐための削記のような保護膜を 形成させることが好ましいが、この保護膜として は被測定放射線を透過しうるものが必要であり、 さらに外部からの可視光を反射する腹を用いるの が放射線の測定膜差を減少できる点より好ましい。 また、別の観点から該保護膜は、シンチレータ膜 内でのシンチレーションによる変換可視光外部へ の飲乱を防止すべく可視光反射性のものを用いる のが好ましい。

かような点から、シンチレータ膜の外面には、 前配のごときアルミニウムのような低密度金属の 蒸菊薄膜を形成させるのが敷も好ましい。

なお、放射線計関に当つて、放射線の照射面は、 通常第1 関矢印の如くシンチレータ膜側とされる を使用してもよい。とれらのうち、基盤の不純物 吸度をできるだけ少なくし、pn 接合付近に生じる 空乏騰をできるだけ厚くするものが好ましい。

上記アレー型半導体光検出案子の上にシンチレータ膜が密着形成される。

この発明のシンチレータ 膜の材質としては、通常のシンチレーションカウンターに用いられる無機シンチレータ、例えば、 $NaI(T\ell)$ 、 $CsI(T\ell)$ 、 $KI(T\ell)$ 、2nS(Cu)、 $CdWO_4$ 等が挙げられ、場合によつては有機シンチレータを用いてもよい。

この発明の特定構造のシンチレータ膜は、例えば、半導体光検出条子の要面に、放射線や可視光を透過しうる SiO x 腹のような 電磁波透過性膜を蒸着等で形成した後、この上に所望のシンチレータを加熱状態で蒸着形成して造膜し、 そののち自然合却させて SiO x 膜の無能 選率とシンチレータ 膜のそれとの差によって垂直 方向の 亀裂を生じ せしめることにより得られる。より具体的には、例えば 0.1~1 μ m 程度の薄い SiO x 膜を 形成させた 電磁液検知ダイオードを予め 200℃に加熱してお

が、逆に半導体光検出素子の底面側に設定しても よく、同様な放射線計測を行なうことができる。

以下、この発明を実施例により説明する。 実施例1

第1図に示すような数細針状区面 造の Cs I (Te) シンチレータ膜(160 μm 厚)を形成した C

特開昭59-122988(4)

の発明の放射線計翻器を用いて種々のエネルギーのX線の計画を行ないそのチャンネル当りの出力 を調べた。なお、ミンチレータ膜を形成していない同様なフォトダイオードについても出力を調べ 比較を行なつた。

その結果を第3図に示す。図においてAはこの発明の放射練計測器による出力を示し、BはCsI(Te)結晶接合前の出力(比較例)を示す。また第3図のデータを基にした出力比(A/B)の変化を第4図に示す。

これらの図に示されるように、 X 線管球電圧 V = 50 kV での出力はシンチレータ 版 を 有していないものに比して 1.35 倍、 V = 100 kV では 2.8 倍となっており、放射線検知効率の向上に基づく 経度の上昇が認められ、ことに硬 X 線において顕著な感度上昇が見られる。

実施例2

放射線検知部間すなわちフォトダイオードのア レーの隣接エレメント間の干渉を調べた。まず、 第5 図のごとく、間隔 0.3 == の 2 つの n 型半導体

(3)、(3a)、(3b) ··· n 型半導体領域、

(4)···SiOz 滋养膜。 (5

(5)…シンチレータ膜、

51)…微期針状区面、

(6)…保範膜、

(7)…湖定器、

(8)…鉛板。

代理人 弁理士 野 河 位大郎

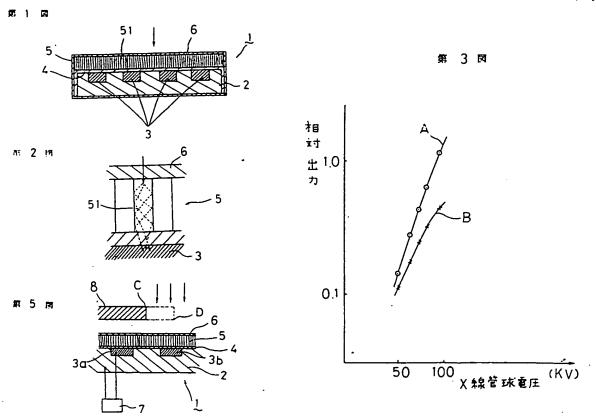
領域(3a)(3b)間の干渉を調べるべく4 雪厚の鉛板(8)を約1 雪の間隔で放射線受光面に位置して遮断し、その遮断位置をC及びDに設定して遮断されたn型半導体領域(3a)に対する遮断効果を測定器(7)で測定し、シンチレータ膜内でのクロストーキング現象の程度を調べた。その結果、いずれの遮断状態においてもn型半導体領域(3a)への影響はほとんど見られず、シンチレータ膜内でのクロストーキング現象はほとんど見られないことが判明した。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の放射線計湖素子の具体例を示す模式的構成説明図、第2図は第1図の要部拡大図、第3図及び第4図は、この発明の放射線計測素子による放射線検知出力を比較例と共に示すグラフ、第5図はこの発明の放射線計測素子におけるシンチレータ膜の効果の測定方法を例示する様式的構成説明図である。

(1) ··· 放射線計測素子、(2) ··· p型半導体系体、

特周昭59-122988(5)



997 /, my

